



DISCO

Kiru · Kezuru · Migaku Technologies



Electroformed Bond Blades Z05 SERIES

選択範囲が広がった高性能ブレード

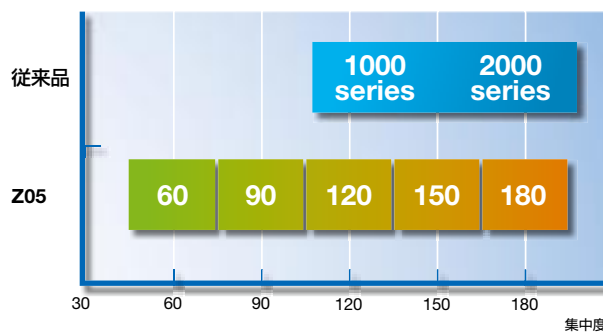


硬脆材料から基板切断まで様々な用途に対応する 優れた研削力を持つZ05シリーズ

ディスコ独自の技術が生んだ高性能電鍍ブレード「Z05」シリーズ。新たな要素技術の投入により、Z05では2つのタイプからお選び頂けるようになりました。硬脆材料からBGA等の各種パッケージ切断などに幅広く対応します。

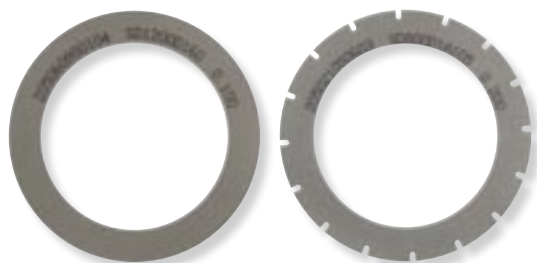
- 複数の集中度から選択が可能なタイプ
 - 集中度の選択範囲を最大5段階とし、より細かな品種選びが可能となりました。
 - 硬脆材料等において、ライフとクオリティのバランスがとれた製品選びが可能となります。
- 加工クオリティを重視したタイプ
 - ブレード先端部分の形状変化を抑制し、安定した切れ味を持続することが可能です。
 - 樹脂バリ、金属バリの低減に効果を発揮します。

■集中度範囲



集中度は、ダイシング加工において消耗量（ライフ）と品質（チップングサイズ等）に影響し、その集中度を高精度に制御することで、消耗量と品質をより安定化させることが可能です。

集中度とは、ブレードに含まれているダイヤモンド砥粒の割合を示す値です。例えば集中度100とは、体積の25%を砥粒が占めている状態です。



加工対象 チップLED基板、生セラミックス、硬脆材料、他

